

2025年度 (2026年3月期) 決算説明会

2026/05/13

株式会社東京精密

代表取締役社長CEO

木村 龍一

取締役 半導体社 執行役員カンパニー長

伯耆田 貴浩

計測社 執行役員カンパニー長

石川 一政

執行役員常務 CFO

小泉 公人

- ・ **将来の事象に係る記述に関する注意：** 本資料に記載されている情報、ならびに口頭で提供される情報は、現時点で入手可能な情報をもとに、当社が合理的であると判断した一定の前提に基づいております。これらは、市況、競争状況、半導体業界、ならびに自動車関連業界等の世界的な状況を含む多くの不確実な要因の影響を受けます。従って、今後の当社の実際の業績が、本資料に記載されている情報と大きく異なる場合がありますことをご承知おき下さい。
- ・ **用語について：** 注記がある場合を除き、半導体製造装置セグメントを「半導体」、精密計測機器セグメントを「計測」、親会社株主に帰属する当期純利益を「当期純利益」、中期経営計画を「中計」と記載します。
- ・ **記入データについて：** 記載されている金額や比率の情報は「億円」、またはパーセント(%)による要約表示を行っております。その為、内訳の計が合計と一致しない場合があります。
- ・ **監査について：** 本プレゼンテーション資料は、監査法人による監査の対象外です。

エグゼクティブサマリー

2025年度 業績	<ul style="list-style-type: none">売上高は1,668億円(前期比+11%、既往ピーク更新)、受注高は1,631億円(同+12%)、半導体製造装置(以下 半導体) でHPC向けが牽引純利益は前期比ほぼ横ばい、年間配当 1株262円(同+9円)を予想
中期経営計画 初年度総括	<ul style="list-style-type: none">「長期成長に向けた準備」と「期間の成長」の両立を推進「戦略製品の成長促進」を進め、高付加価値プロローバを展開生産キャパシティ拡張に向けた取り組みも推進
2026年度 業績予想	<ul style="list-style-type: none">半導体、計測機器とも中期経営計画の前提に沿った環境を想定HPCの強い需要、付加価値製品の拡大が増収増益に貢献利益率の上昇も見込む

- 代表取締役社長CEOの木村です。
本日はご多忙のところ、ご参加いただきまして 厚く御礼申し上げます。
- まず私から、2ページ目、本日の説明のサマリーを説明いたします。
- 2025年度の業績は、売上高は前期比プラス11%増で既往ピークを更新、受注高はプラス12%となりました。半導体製造装置部門で、HPC向けの引合いが牽引しました。純利益も、特別損失があるなかでほぼ横ばいとなり、増配予想へ変更できました。
- 中期経営計画 初年度の総括として、取り組んでいた「長期的な成長に向けた準備」と「期間の成長」の両立を推進して参りました。高付加価値プロローバの展開や、生産キャパシティ拡張に向けた取り組みを進めております。
- 今年度、2026年度ですが、中期経営計画の前提に沿った市場環境を想定しています。特に半導体でのHPC需要の強さや、これに伴う高付加価値製品の拡大により、増収増益の予想となっており、また、製品ミックスの改善などにより利益率の上昇も見込んでおります。
- サマリーは以上となります。では小泉より2025年度の業績を説明いたします。

2025年度 連結業績

売上高は既往ピークを更新、営業利益・経常利益も増加

全社業績(億円)		2024年度	2025年度	2月予想比	前期比
受注高		1,456	1,631	-	+12%
売上高		1,505	1,668	+18	+11%
営業利益		297	337	+17	+14%
(利益率)		(20%)	(20%)	-	+0pt
経常利益		299	348	+28	+16%
当期純利益		256	247	+32	-4%
研究開発費		104	120	+0	+16%
設備投資		102	111	-9	+8%
減価償却費		51	56	+1	+9%
1株配当(円)		253円	262円	+40円	+9円
セグメント別業績		2024年度	2025年度	2月予想比	前期比
半導体 製造装置	受注高	1,077	1,234	-	+15%
	売上高	1,135	1,279	+4	+13%
	営業利益	243	284	-	+17%
	(利益率)	(21%)	(22%)	-	+1pt
計測機器	受注高	379	397	-	+5%
	売上高	371	390	+15	+5%
	営業利益	54	53	-	-1%
	(利益率)	(15%)	(14%)	-	-1pt

- 執行役員常務CFOの小泉です。よろしくお願い致します。私からは2025年度の業績を説明させていただきます。
- 3ページは業績の総括です。上段の売上高ですが、特に半導体製造装置部門が前期比で伸びたことで既往ピークを更新し、これに伴い営業利益も増加しました。前期までの受注残を計画通り出荷に結びつけたこと、過去2番目の受注高を記録したことも、伸びの要因となりました。
- 経常利益は、為替差益が出たこともあり、営業利益以上の伸びとなりました。
- また、純利益ですが、第2四半期に特別損失を計上しておりましたが、概ね前期並みの着地となりました。
- 純利益が2月予想を上振れましたので、期末配当予想も修正いたしました。詳しくは適時開示をご覧ください。
- 下段はセグメント別の結果です。半導体は、10%超の増収増益、計測は5%の増収でしたが利益面ではほぼ横ばい圏での着地でした。

2025年度 第4四半期 連結業績

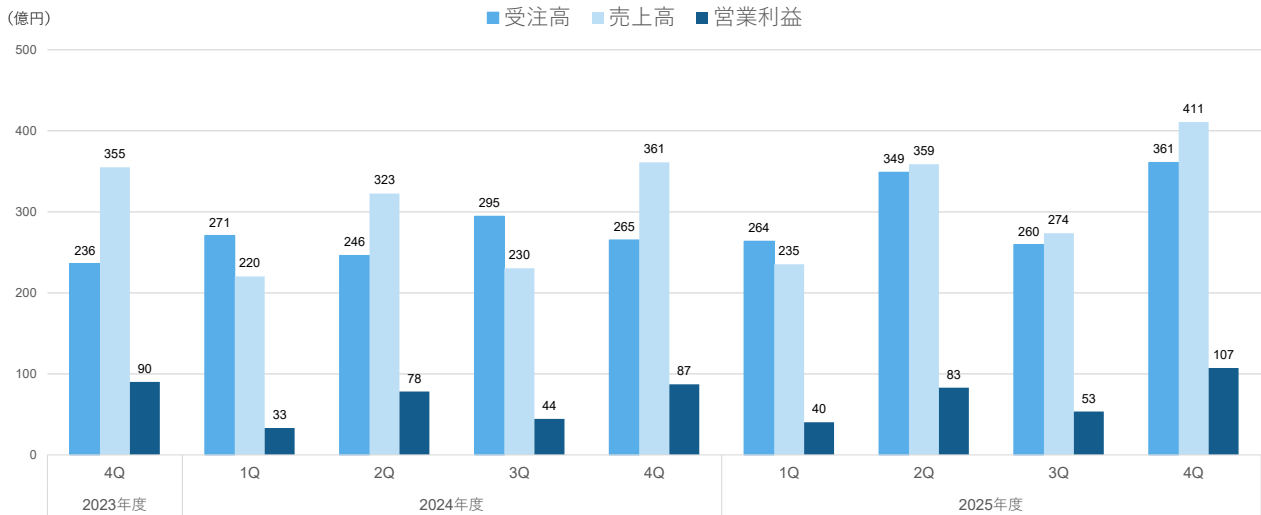
四半期売上は既往ピークを更新、利益率も上昇

全社業績(億円)	2024年度 1Q	2Q	3Q	4Q	2025年度 1Q	2Q	3Q	4Q	前四半期比	前年同期比	
受注高	374	337	392	353	359	447	366	458	+25%	+30%	
売上高	296	418	317	474	309	462	359	539	+50%	+14%	
営業利益	41	93	57	106	46	101	62	128	+106%	+20%	
(利益率)	(14%)	(22%)	(18%)	(22%)	(15%)	(22%)	(17%)	(24%)	+7pt	+1pt	
経常利益	43	88	66	101	45	105	67	131	+95%	+29%	
当期純利益	36	100	46	75	32	64	45	106	+133%	+41%	
研究開発費	23	28	25	28	25	30	29	36	+21%	+29%	
設備投資	28	12	24	39	25	44	15	27	+78%	-31%	
減価償却費	12	13	13	13	12	14	14	16	+7%	+13%	
セグメント別業績	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	前四半期比	前年同期比	
半導体 製造装置	受注高	271	246	295	265	264	349	260	361	+39%	+36%
	売上高	220	323	230	361	235	359	274	411	+50%	+14%
	営業利益	33	78	44	87	40	83	53	107	+101%	+23%
	(利益率)	(15%)	(24%)	(19%)	(24%)	(17%)	(23%)	(20%)	(26%)	+7pt	+2pt
計測機器	受注高	103	91	98	87	95	98	107	97	-9%	+12%
	売上高	76	95	87	113	73	103	85	128	+50%	+13%
	営業利益	8	15	12	19	5	18	9	21	+140%	+9%
	(利益率)	(10%)	(16%)	(14%)	(17%)	(7%)	(18%)	(10%)	(16%)	+6pt	-1pt

- 4ページは、四半期の業績推移となります。
- 上段にあります通り、第4四半期は受注・売上・利益とも第3四半期から大幅に増加、前年同期比でも大きくプラスとなり、売上高は既往ピークとなりました。
- 第4四半期は、計画していた出荷・据付が概ね想定通り実行できたほか、前倒しの売上が計上できたことで、社内計画を上振れる着地となりました。
- 第4四半期の営業利益率は24%となりました。トップラインの上昇のほか、下段にあるとおり、半導体の利益率が26%になったことが主因です。高付加価値のプローバの売上も、利益率の改善に寄与しました。

半導体製造装置セグメント 業績推移

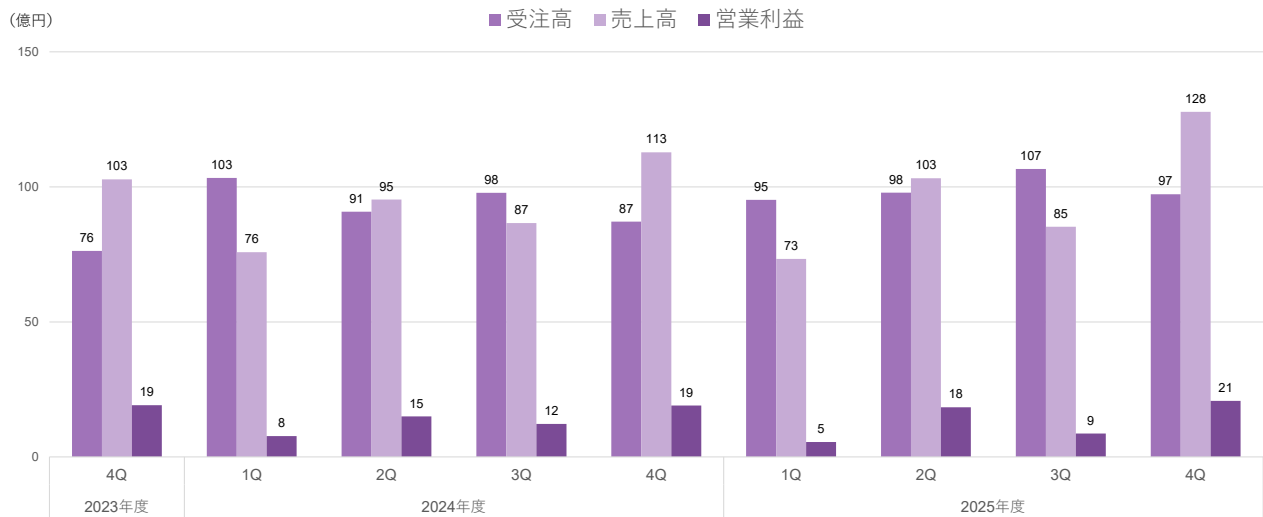
第4四半期の受注高は、HPC向けで想定線、他案件での上振れとなり、
受注残高の一部整理(約10億円マイナス)があるなかでも想定をやや上回る着地となった



- 5ページは、半導体の受注高・売上高・営業利益の四半期推移をグラフで示したものです。受注高について説明いたします。
- 第4四半期の受注高は361億円で、会社想定 of 300億円台半ばから若干上振れました。生成AIを含むHPC向けの受注は、会社の想定線でしたが、それ以外の中国案件などが想定を上回りました。
- なお、この第4四半期も、売上の実現性が低いと判断した受注残高の整理を行っており、約10億円のマイナスが含まれています。
- またHPC関連の情報、地域別動向、アプリケーション動向などの定量情報は、開示資料の22ページ以降の補足資料に入れておりますので、併せてご覧ください。

計測機器セグメント 業績推移

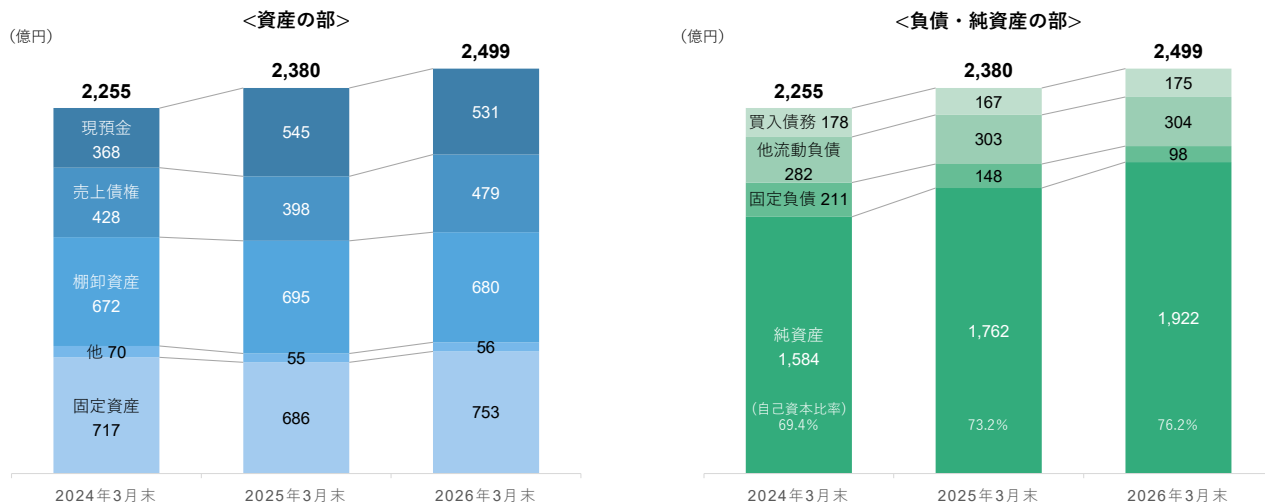
第4四半期の受注高は会社想定を上回る着地



- 6ページは、計測の受注高・売上高・営業利益の四半期推移です。
- 第4四半期の受注高は97億円で、会社想定の80億円台半ばから上振れとなりました。
- これは、自動車業界におけるハイブリッド車の生産に関連した追加投資や、日本の中小企業に向けた補助金を活用した投資の恩恵によるものです。

貸借対照表

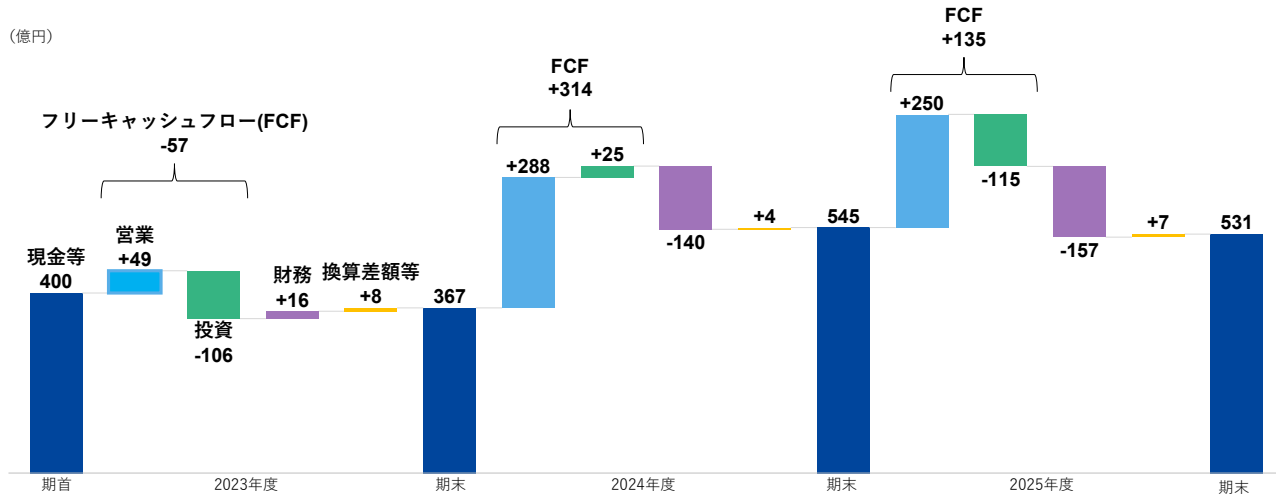
工場竣工により固定資産、売上高の増加により売上債権が増加



- 7ページは貸借対照表の説明です。
- 2026年3月末の総資産は、2,499億円となりました。
- 左側、資産の部ですが、固定資産が名古屋工場の竣工により増加したほか、売上債権が増加しました。棚卸資産と現金・預金は、前期末対比で概ね横ばいでした。
- 右側、負債・純資産の部については、借入金の返済が進み、負債が減少しました。
- 3月末の自己資本比率は 76.2%となりました。

キャッシュフロー

営業キャッシュフローの一定水準確保により、フリーキャッシュフローはプラス

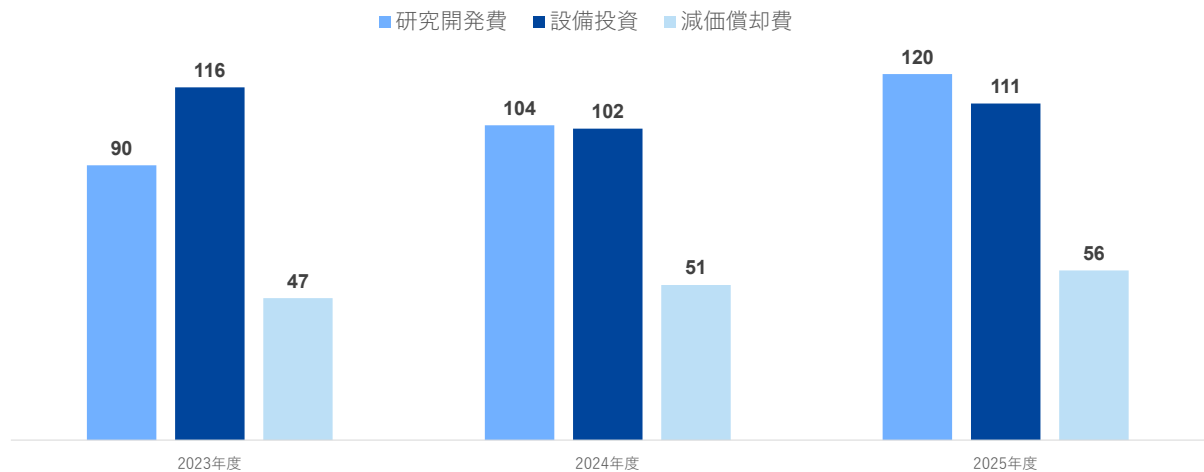


- 8ページはキャッシュフローの説明です。右側が2025年度の実績です。
- 営業活動キャッシュフローは、プラス250億円となり、投資キャッシュフローは固定資産の取得によりマイナス115億円となりました。設備投資が続く中でも、フリーキャッシュフローはプラス135億円となりました。
- 財務活動キャッシュフローは、配当金の支払い、借入金の返済などでマイナス157億円となりました。
- これにより、期末現預金残高は、前期末とほぼ横ばいの531億円となりました。

研究開発費・設備投資・減価償却費

将来の成長に向けた投資を着実に実行

(億円)



- 9ページは研究開発費・設備投資・減価償却費の実績です。
- 2025年度の研究開発費は、ほぼ計画通りの120億円となりました。
- 設備投資は、111億円となりました。名古屋工場や、韓国デモセンターなどの投資を行いましたが、一部案件の検収が2026年度以降に延伸したため、計画からは若干下振れとなりました。
- 減価償却費は計画線の56億円となりました。
- ここまでが、2025年の実績説明となります。次に、木村から、中期経営計画の初年度の総括を説明いたします。

2025-2027年度 中期経営計画 初年度総括

- 木村です。
- 当社は、2025年度から2027年度までの3か年の中期経営計画を進めており、ここで初年度、2025年度の成果を総括いたします。

中期経営計画(2025-2027年度)の位置づけ

2025年5月9日開示資料 再掲

中期経営計画(2025-2027年度)では、「長期成長に向けた準備」と「期間の成長」とを両立する



- まず、昨年5月に開示した中期経営計画の要約を説明します。
- 11ページは、中期経営計画の位置づけについてです。
- 今回の中期経営計画は、当社のパーパス「計測で未来を測り、半導体で未来を創る」という考え方をもとに、長期的に「当社の製品やサービスがなければモノを作れない、測れない」というポジションを確立してゆくためのステップであると考え、足場固めと、期間の成長を両立させていく期間、と位置付けました。

中期経営計画(2025-2027年度)の基本方針

事業強化と事業基盤そのものの強化を両立させる

2025年5月9日開示資料 再掲

戦略製品の成長促進

- 半導体製造装置：
 - 高付加価値ブローバ
 - 先端グラインダ
 - 先端ダイサ 等
- 計測機器：
 - 充放電試験システム
 - X線検査装置 等

計測・半導体の技術シナジー追求

- 精密計測機器をビルトインした新たな半導体製造装置
- 計測アプリケーションの半導体エリアへの応用

リカーリングビジネス強化

- 半導体製造装置：
 - サービス/サポートビジネス強化
 - 消耗品事業拡大
 - 既設装置向け事業機会創出
- 計測機器：
 - 受託計測・評価サービス拡充
 - 機器校正サービス強化

これらを支える事業基盤の強化

要素技術開発の強化促進

セグメント横断的な事業戦略組織

新たなチャレンジを促す環境

ITを活用した生産性向上

サステナビリティ
マネジメントの進化

- 12ページは、中期経営計画の基本方針です。
- 大方針として、上段「戦略製品の成長促進」、「計測・半導体の技術シナジー追求」、「リカーリングビジネスの強化」の3項目、そしてこれらを支える事業基盤の強化として、下段の項目を定めました。

中期経営計画(2025-2027年度) 初年度総括 定量目標

2025年5月9日開示資料 再掲

2024年度実績に対し、約20%増収、50%増益の目標を設定

	2024年度 実績	中期経営計画期間 (2025-2027年度) 単年度	前提
売上高	1,505億円 半導体1,135億円 計測371億円	1,850億円 半導体1,400億円 計測450億円	● 定量目標：単年目標として設定(市場ボラティリティを考慮)
営業利益	297億円 半導体243億円 計測54億円	450億円	● 半導体：対象市場のCAGR前提 +5%をアウトパフォーム
営業利益率	20% 半導体21% 計測15%	24%	● 計測：非自動車(半導体, 航空, 宇宙など)の持続的な市況回復
ROE	15%	15%	● 営業利益：売上増(高付加価値製品を含む) 原価低減の進展、リカーリングビジネス推進
			● ROE：純利益の積み増し
			● リスクファクター： ● 民生アプリケーション需要の不確実性 ● 地政学リスク(中国の装置需要・競合等) ● 工作機械受注の鈍化

- 13ページは、中期経営計画の定量目標です。
- 当社独自の事業機会を獲得することで、対象市場の成長前提 プラス5%を上回る成長を遂げ、売上高を2024年度比 20%増収の1,850億円にすること、同時に、高付加価値製品の比率拡大、原価低減活動、リカーリングビジネスの推進などを通じて営業利益450億円、利益率で24%を狙う計画を設定しました。

中期経営計画(2025-2027年度) 初年度総括

全体方針・基本方針に沿ったアクションを着実に実行

戦略製品の成長促進

半導体：高付加価値製品の開発強化

- ・ 高精度温度制御機能付きプローバ → HPC向け需要の獲得に貢献
- ・ Hybrid Bonding用グラインダ、大型PLP向け加工装置等

計測：各種機器の高機能化、高付加価値化

- ・ 大型高精度測定機の展開 → 航空・宇宙・防衛分野の新規需要を獲得
- ・ オートメーション機能強化、充放電試験システムサービス強化

計測・半導体の 技術シナジー追求

ソリューション提案の強化

- ・ プローバ・ダイサ・グラインダへ「計測ビルトイン」を展開
- ・ 計測機器の半導体・半導体製造装置分野への拡販強化

リカーリングビジネス 強化

消耗品販売促進活動、開発強化

- ・ 特にダイシングブレードで新製品の開発・展開を強化

サービス活動の拡大

- ・ メンテナンス、機器校正サービス提案活動強化
- ・ リカーリングビジネスのシステム管理の仕組み構築

- 14ページに、初年度の総括を示しております。
- 上段、戦略製品の成長促進ですが、半導体では、付加価値の高い高精度温度制御機能付きのプローバを中心に、現在、市場が必要とする製品を展開したほか、計測でも、航空・宇宙・防衛など 新規分野のニーズにマッチした製品の展開を進めました。
- 計測・半導体の技術シナジー追求ですが、既にプローバ、ダイサ、グラインダで、計測技術を応用した製品や機能を多数展開しているほか、計測製品の半導体デバイスメーカーや製造装置メーカーへの拡販を進めています。
- 下段、リカーリングビジネスの強化ですが、ダイシングブレードなどの消耗品の開発・販売の促進に努めているほか、メンテナンス・校正サービスなどの強化を進めています。
- いずれも、3か年のマイルストーンに沿った結果となっています。

キャッシュアロケーション 初年度総括

将来の成長に向けた投資を着実に実行

研究開発投資

開発強化、3年累計で350～400億円を想定

戦略製品開発、要素技術開発、計測と半導体のシナジー技術開発
他社との共同研究開発の推進 等

→ 初年度 投資額:120億円

高精度温度制御プローバ、先端アプリケーションに向けた
製品力の強化

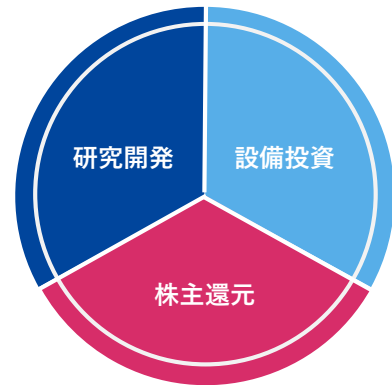
設備投資

将来を見据え、3年累計で累計300～400億円^(*)を想定

- 成長投資：名古屋工場、八王子新工場、
韓国デモセンター新設、二次電池評価機能拡張等
- 事業基盤強化：IT強化、業務効率化、ESG関連投資

→ 初年度: 111億円

名古屋工場、韓国デモセンター、二次電池評価センター
他 中期案件として計画した投資 (飯能工場近隣地の新建屋、八王子新工場等)



(*) 工事進捗により変動

- 15ページは、キャッシュアロケーションの方針と、初年度の総括です。
- 研究開発投資は、3年間累計で350億円から400億円を投じ、戦略製品や要素技術の開発、半導体と計測のシナジー技術の開発を行う方針でした。初年度は120億円を投じ、高精度温度制御プローバなど、製品力の強化を中心とした開発を行いました。
- 設備投資は、300億円～400億円を投じ、成長投資と事業基盤の強化を行う方針でした。初年度の設備投資額は111億円で、名古屋工場を竣工、韓国におけるデモセンター建設を進めたほか、計測事業 充放電試験システムを使った評価センターを立ち上げました。
- 以上のように、中期経営計画の実行内容は、計画に概ね沿ったものであり、2026年度以降も、このまま実行して参る所存です。

2026年度 通期業績予想

- 次に、2026年度の計画と、今後の見通しについて説明いたします。

2026年度通期業績予想の前提

売上・営業利益

半導体：生成AIを含むHPC案件による売上増、メモリ・ロジック向けの引合に強い期待、通期で増収を計画

- 生成AIを含むHPC：引き続き売上高・利益に大きく貢献(4割程度)
- グローバルOSAT：HPC向けに加え他ロジック向けの増加を想定
- 中国需要：ハイエンド需要を中心に高水準
- 汎用メモリ：DRAM/NAND向けの出荷増加

計測：ものづくり市場全般の回復に加え、価格改定や航空・宇宙・防衛分野、半導体関連の売上増を想定

利益：引き続きコスト増圧力はあるが、高付加価値製品比率の増加・原価改善+αを通じ中期経営計画目標に近づける

受注動向

半導体：上期はHPC・中国向けが堅調、さらにメモリ・ロジック向けの増加を期待。下期計画は未策定だが、高水準を想定

- 生成AIを含むHPC：上期はHBM向けの増加を主因に2025年度下期比で+20%程度を想定
- グローバルOSAT：全般に引き合いが強まる
- 中国需要：ハイエンド需要が継続すると想定
- 汎用メモリ：DRAM/NAND向けの引合いが加速

計測：航空・宇宙・防衛分野、半導体関連需要の増加、及び補助金の活用による引合増加を想定

- 17ページには、2026年度の通期業績予想の前提を示しています。
- 上段は売上・利益面の考え方です。2026年度、半導体では生成AIを含むHPC需要が業績に貢献するほか、グローバルOSATのロジック投資拡大、中国のハイエンド需要、さらに汎用メモリ向けの引合いが貢献し、総じて増収を見込んでいます。
- 計測では、航空・宇宙・防衛分野や、半導体関連需要を中心に、ものづくり市場全般の需要回復を見込んでおり、こちらも増収を想定しています。
- 2月の説明会で、2026年度の業績は中期経営計画の定量目標に近い水準をイメージしていると申し上げましたが、今年度の予想はその目線にあると考えています。
- 受注動向の考え方は下段の通りです。定量的な開示は上期のみとなりますが、現時点では下期も高水準の受注を見込んでいます。

2026年度通期業績予想

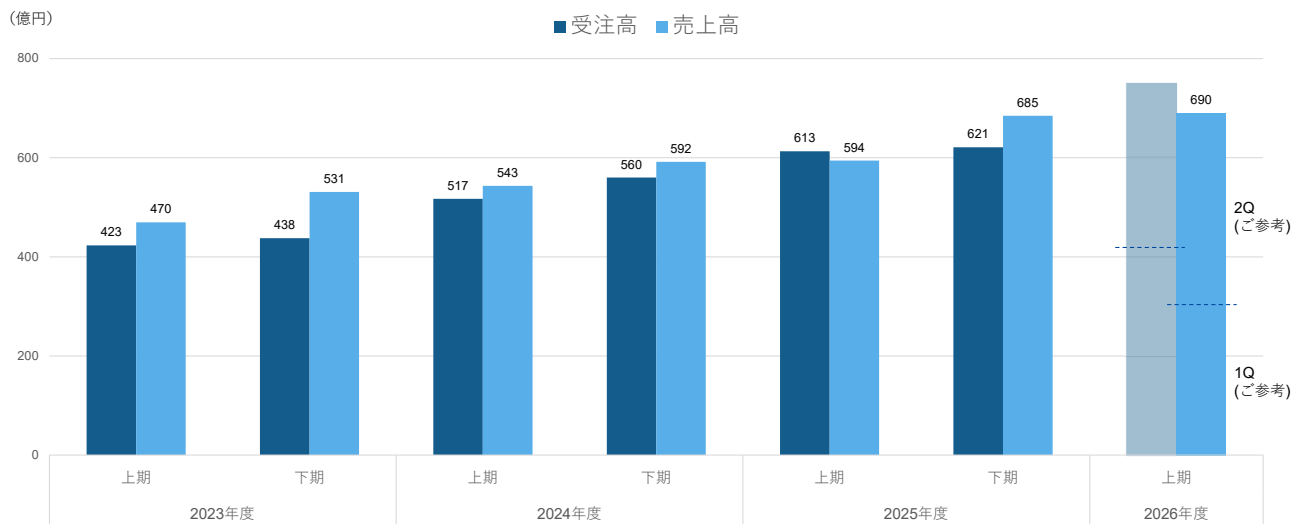
下期も堅調な事業環境が想定されるが、合理的に見積もることが可能な範囲内で業績予想を作成
特に半導体製造装置の高付加価値製品(プローバ)がけん引し、増収増益となる想定
前提為替レートは150円/ドル (為替変動影響は軽微：円建て比率高)

全社業績(億円)	2025年度 上期	2025年度 下期	2025年度 通期	2026年度 上期 予	2026年度 下期 予	2026年度 通期 予	前期比
受注高	806	825	1,631	-	-	-	-
売上高	771	898	1,668	875	940	1,815	+9%
営業利益	147	190	337	187	213	400	+19%
(利益率)	(19%)	(21%)	(20%)	(21%)	(23%)	(22%)	+2pt
経常利益	150	199	348	187	213	400	+15%
当期純利益	96	151	247	131	149	280	+13%
研究開発費	55	65	120	-	-	130	+8%
設備投資	69	42	111	-	-	110	-1%
減価償却費	27	29	56	-	-	62	+11%
セグメント売上高	2025年度 上期	2025年度 下期	2025年度 通期	2026年度 上期 予	2026年度 下期 予	2026年度 通期 予	前期比
半導体製造装置	594	685	1,279	690	725	1,415	+11%
計測機器	177	213	390	185	215	400	+3%
1株配当(円)	111円	151円	262円	138円	138円	276円	+14円

- これらの前提を踏まえた2026年度の通期業績予想を18ページに記載しています。現時点で下期の業績は見通しづらいものの、上期の受注水準をベースに、合理的に見積もれる範囲で業績予想を作成しています。
- 具体的には通期では全社売上高 で前期比9%増の1,815億円、営業利益は19%増の400億円、経常利益は15%増の400億円、当期純利益は13%増の280億円を計画しています。
- セグメント別の売上は、半導体が11%増の1,415億円、計測が3%増の400億円です。半導体を中心に業容が拡大する前提です。
- 研究開発費等の計画は中段に記載しています。
- 前提為替レートは、1ドルが150円です。為替変動による業績への変動は、引き続き軽微と見積もっております。
- なお配当については、1株276円を予想しています。

半導体製造装置セグメント- 売上・受注高 半期見込

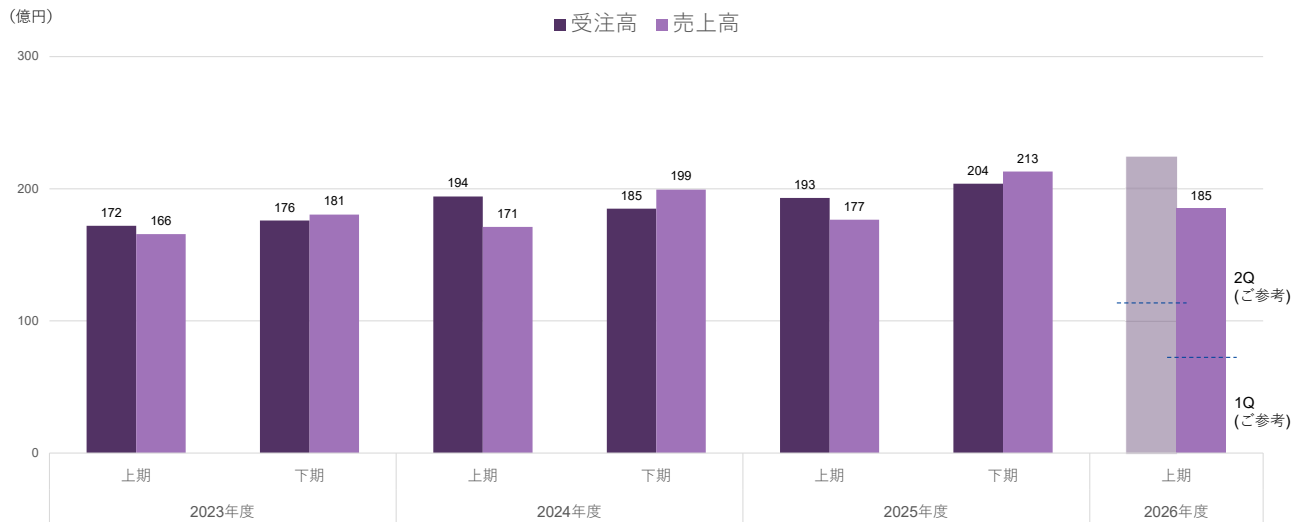
2026年度上期受注高は前年同期比で20%増を想定



- 19ページは、半導体事業の 売上高及び受注高の、半期ごとの見込みです。
- 2026年度上期の受注高は、前年下期比で約20%の増加を想定しています。
- なお、ご参考に、社内計画をベースにした四半期別の按分のイメージを破線で記載しました。この上期は、受注は第1四半期に、売上は第2四半期にやや集中するイメージを持っております。
- なお、上期の予想の製品構成比は、売上高は、検査装置、プローバ 7割、加工装置3割、受注高は、検査装置、プローバ 7割半ば、加工装置2割半ばを想定しており、プローバのミックスが高まる想定です。

計測機器セグメント – 売上・受注高 半期見込

2026年度上期受注高は前年同期比で10%増を想定



- 20ページは、計測事業の売上高及び受注高の、半期ごとの見込みです。
- 上期の受注高は、前年度下期比で約10%の増加を想定しています。
- 上期予想の製品構成比は、売上高、受注高ともに、汎用計測 7割、自動計測が2割、残りが充放電試験システムを想定しています。
- こちらも四半期別の按分のイメージを記載しました。季節性により、受注は第1四半期に、売上は第2四半期にやや偏る計画です。
- 以上で私からの説明を終わります。ご清聴 ありがとうございました。

質疑応答 / Q&A

Supplementary Data - 生成AIを含むHPC / HPC-related business incl. Gen.AI

<売上高/Sales>

(前半期比増減率 / HoH Changes)	2025年度上期 FY2026/3 1H	2025年度下期 FY2026/3 2H	2026年度上期予 FY2027/3 1H (f)
生成AIを含むHPC 全体 HPC-related incl. Gen. AI	前半期比 +55% HoH	前半期比 +32% HoH	前半期比 +18% HoH
うちロジック (生成AIを含む) of which Logic (incl. Gen AI)	前半期比 +81% HoH	前半期比 +11% HoH	前半期比 +1% HoH
うちHBM of which HBM	前半期比 +28% HoH	前半期比 +64% HoH	前半期比 +35% HoH
SPE売上高に占めるHPC関連の割合 HPC-related proportion of total SPE sales	30%強 / Low 30%	30%半ば / Mid-30%	40%強 / Low 40%

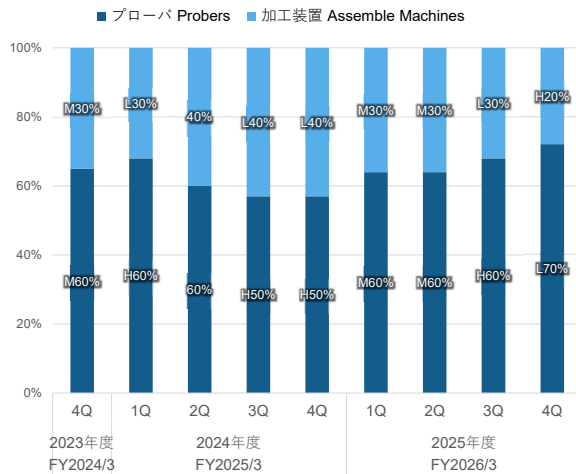
<受注高/Orders>

(前半期比増減率 / HoH Changes)	2025年度上期 FY2026/3 1H	2025年度下期 FY2026/3 2H	2026年度上期予 FY2027/3 1H (f)
生成AIを含むHPC 全体 HPC-related incl. Gen. AI	前半期比 +24% HoH	前半期比 +4% HoH	前半期比 +15% HoH
うちロジック (生成AIを含む) (*) of which Logic (incl. Gen AI) (*)	前半期比 -11% HoH	前半期比 +84% HoH	前半期比 -16% HoH
うちHBM of which HBM	前半期比 +65% HoH	前半期比 -48% HoH	前半期比 +88% HoH
SPE受注高に占めるHPC関連の割合 HPC-related proportion of total SPE orders	40%	40%	40%強 / Low 40%

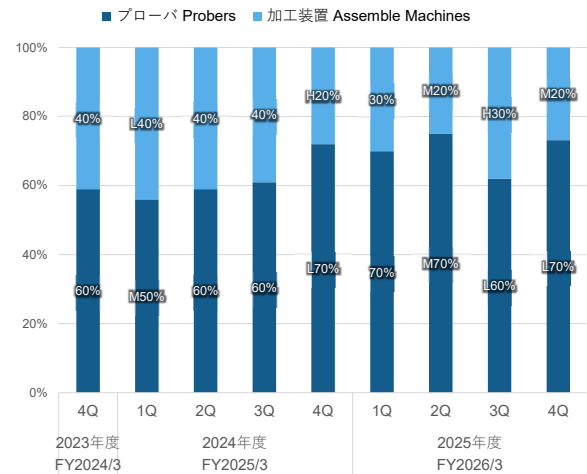
- 変動が大きいため、四半期別の開示は行っておりません。 Due to significant volatilities, the Company does not provide quarterly forecasts.
- 『生成AIを含むHPC全体』は、『うちロジック(生成AIを含む)』および『うちHBM』の合計です。『うちロジック(生成AIを含む)』には、ロジックデバイス向けブローパやAIパッケージング向けの加工装置の需要が含まれています。なお、当社は製品の特性上、検査や加工がおこなわれる半導体デバイスの種別を特定することが困難であることから、生成AIに限定した分類は行っておりません。"HPC-related incl. Gen.AI" represents the sum of 'of which Logic (incl. Gen AI)' and 'of which HBM'. The 'of which Logic (incl. Gen. AI)' encompasses businesses for probers for logic devices and assembly equipment for AI packaging. Note that due to the nature of our products, it is difficult to identify the specific types of semiconductor devices undergoing inspection or processing; consequently, the Company does not undertake classification limited solely to Generative AI.

Supplementary Data - 製品別構成比 半導体 / SPE Segment per Product

<売上高 Sales>

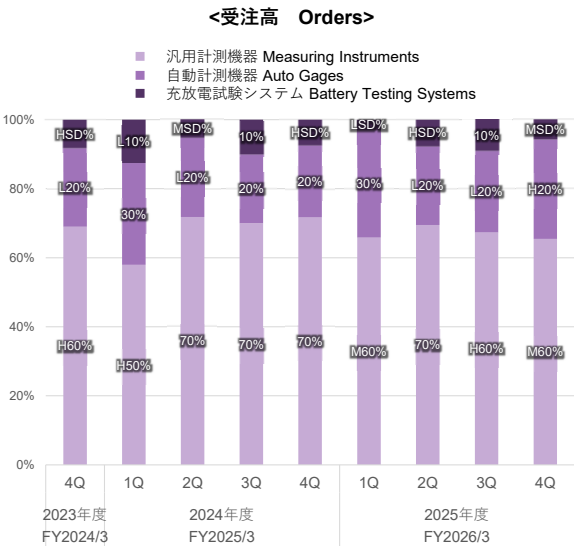
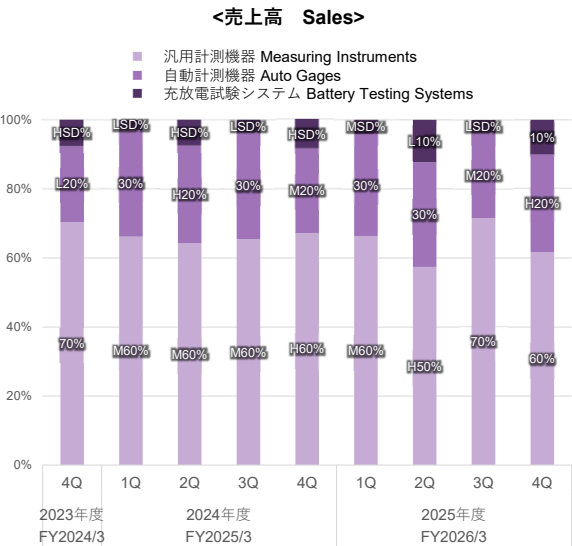


<受注高 Orders>



%表記 : L:Low(前半), M:Middle(半ば), H:High(後半)、0-3%:LSD(Low Single Digit)、4-6%:MSD% (Mid Single Digit)、7-8%:HSD% (High Single Digit)

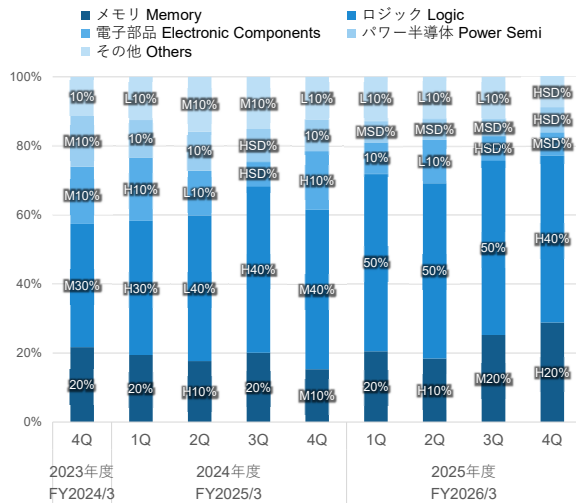
Supplementary Data - 製品別構成比 計測 / Metrology Segment per Product



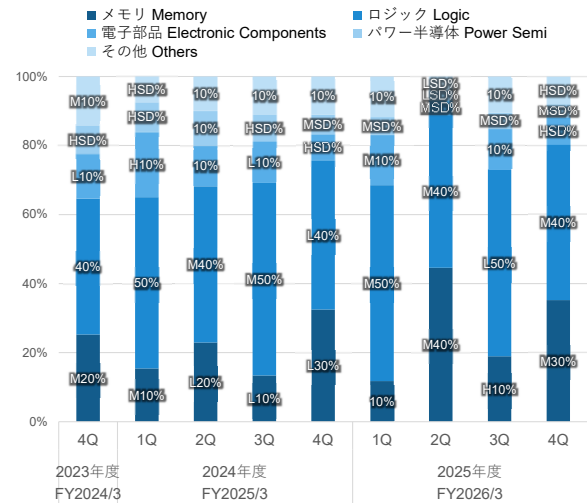
%表記 : L:Low(前半), M:Middle(半ば), H:High(後半)、0-3%:LSD(Low Single Digit)、4-6%:MSD% (Mid Single Digit)、7-8%:HSD% (High Single Digit)

Supplementary Data - アプリ別構成比 半導体 / SPE Segment per Application

<売上高 Sales>



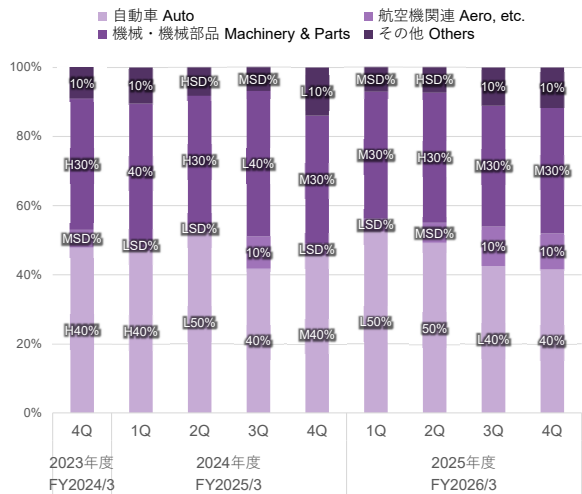
<受注高 Orders>



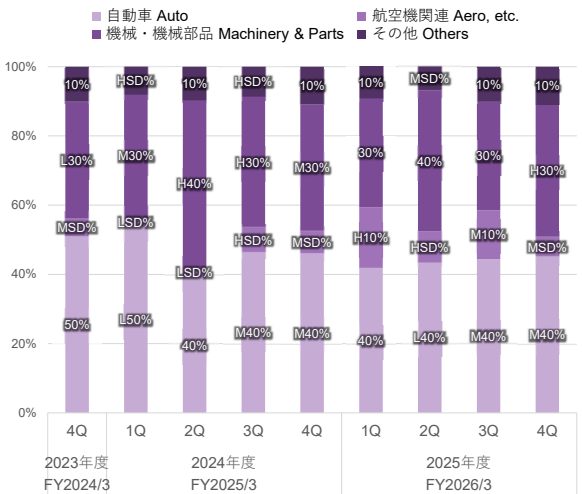
%表記 : L:Low(前半), M:Middle(半ば), H:High(後半)、0-3%:LSD(Low Single Digit)、4-6%:MSD% (Mid Single Digit)、7-8%:HSD% (High Single Digit)

Supplementary Data - アプリ別構成比 計測 / Metrology Segment per Application

<売上高 Sales>



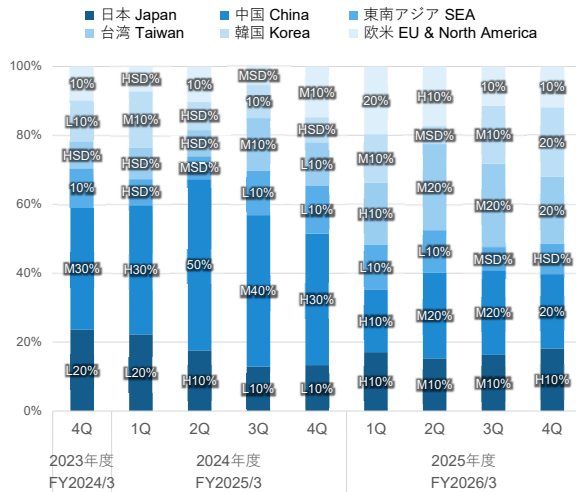
<受注高 Orders>



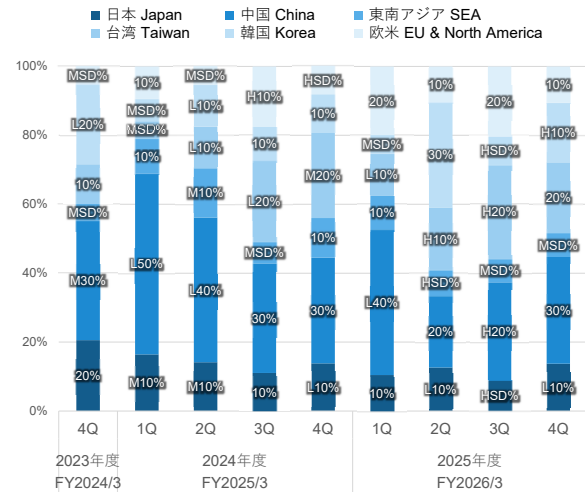
%表記 : L:Low(前半), M:Middle(半ば), H:High(後半)、0-3%:LSD(Low Single Digit)、4-6%:MSD% (Mid Single Digit)、7-8%:HSD% (High Single Digit)

Supplementary Data - 地域別構成比 半導体 / SPE per Region

<売上高 Sales>



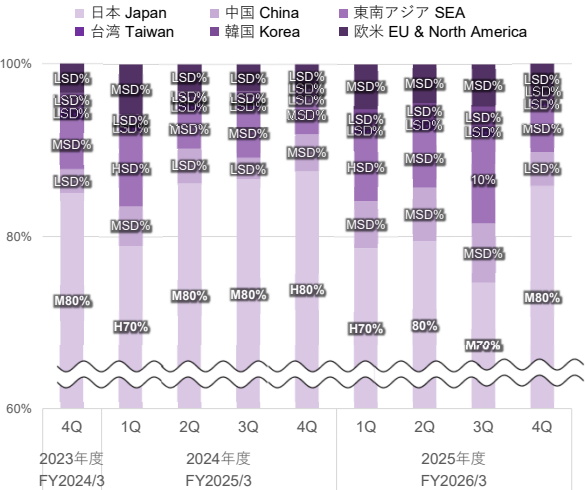
<受注高 Orders>



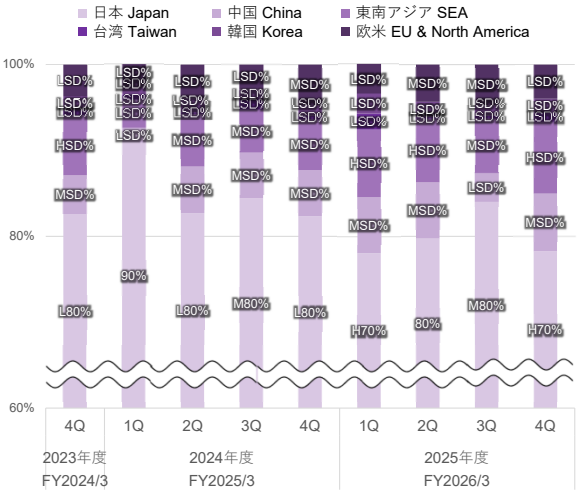
%表記 : L:Low(前半), M:Middle(半ば), H:High(後半)、0-3%:LSD(Low Single Digit)、4-6%:MSD% (Mid Single Digit)、7-8%:HSD% (High Single Digit)

Supplementary Data - 地域別構成比 計測 / Metrology per Region

<売上高 Sales>



<受注高 Orders>



%表記 : L:Low(前半), M:Middle(半ば), H:High(後半)、0-3%:LSD(Low Single Digit)、4-6%:MSD% (Mid Single Digit)、7-8%:HSD% (High Single Digit)
(注) 取引顧客の国籍による分類であり、日本向け売上高・受注高には、第3国への輸出案件が含まれています。 This data classifies based on customers' nationality. Sales and orders for Japan include export transactions to third countries.

Supplementary Data - セグメント別業績推移 / Segment Information

(百万円) Million Yen	会計期間 Fiscal Year				四半期 Quarter								
	2022年 3月期 FY2022/3	2023年 3月期 FY2023/3	2024年 3月期 FY2024/3	2025年 3月期 FY2025/3	2025年3月期 FY2025/3				2026年3月期 FY2026/3				
					1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	
Orders 受注額	半導体 SPE	152,896	99,366	86,082	107,713	27,081	24,631	29,456	26,544	26,378	34,945	25,965	36,106
	計測 Metr.	33,159	36,960	34,802	37,917	10,336	9,082	9,781	8,717	9,523	9,786	10,661	9,728
	合計 Total	186,056	136,326	120,885	145,631	37,417	33,713	39,237	35,262	35,901	44,732	36,627	45,835
Backlog 受注残高	半導体 SPE	102,370	89,371	75,398	69,630	80,433	72,785	79,205	69,630	72,466	71,541	70,134	65,149
	計測 Metr.	9,904	12,428	12,606	13,470	15,362	14,911	16,031	13,470	15,660	15,123	17,257	14,210
	合計 Total	112,274	101,799	88,004	83,101	95,796	87,697	95,236	83,101	88,127	86,664	87,391	79,359
Sales 売上額	半導体 SPE	101,145	112,365	100,055	113,481	22,046	32,280	23,036	36,118	23,542	35,870	27,372	41,092
	計測 Metr.	29,556	34,436	34,624	37,053	7,580	9,532	8,661	11,278	7,333	10,323	8,528	12,775
	合計 Total	130,702	146,801	134,680	150,534	29,626	41,812	31,698	47,397	30,876	46,194	35,900	53,867
OP 営業利益	半導体 SPE	24,698	29,866	19,899	24,311	3,314	7,824	4,449	8,722	4,031	8,297	5,347	10,727
	計測 Metr.	3,628	4,628	5,408	5,392	768	1,497	1,220	1,905	549	1,838	867	2,077
	合計 Total	28,327	34,494	25,307	29,703	4,083	9,322	5,670	10,627	4,581	10,136	6,214	12,805
Op Margin 営業利益率	半導体 SPE	24.4%	26.6%	19.9%	21.4%	15.0%	24.2%	19.3%	24.1%	17.1%	23.1%	19.5%	26.1%
	計測 Metr.	12.3%	13.4%	15.6%	14.6%	10.1%	15.7%	14.1%	16.9%	7.5%	17.8%	10.2%	16.3%
	合計 Total	21.7%	23.5%	18.8%	19.7%	13.8%	22.3%	17.9%	22.4%	14.8%	21.9%	17.3%	23.8%

Supplementary Data - 損益計算書 / Income Statement

(百万円) Million Yen	会計期間 Fiscal Year				四半期 Quarter							
	2022年 3月期 FY2022/3	2023年 3月期 FY2023/3	2024年 3月期 FY2024/3	2025年 3月期 FY2025/3	2025年3月期 FY2025/3				2026年3月期 FY2026/3			
					1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q
売上高 Net Sales	130,702	146,801	134,680	150,534	29,626	41,812	31,698	47,397	30,876	46,194	35,900	53,867
売上原価 Cost of goods sold	77,694	84,967	79,917	88,081	17,753	24,757	17,960	27,609	18,468	27,411	21,063	31,034
売上総利益 Gross Profit on Sales	53,008	61,834	54,762	62,453	11,873	17,054	13,738	19,787	12,407	18,783	14,837	22,832
販売費および一般管理費 Selling, general and administrative expenses	24,681	27,339	29,454	32,750	7,790	7,732	8,067	9,159	7,825	8,647	8,622	10,026
営業利益 Operating profit	28,327	34,494	25,307	29,703	4,083	9,322	5,670	10,627	4,581	10,136	6,214	12,805
営業外収益 Non-operating income	987	965	1,404	921	287	39	539	55	133	309	609	428
営業外費用 Non-operating expenses	153	162	259	684	41	531	-422	534	252	-69	84	126
経常利益 Recurring Profit	29,160	35,297	26,453	29,939	4,329	8,829	6,632	10,148	4,462	10,515	6,739	13,108
特別利益 Extraordinary gains	390	103	824	4,493	10	4,483	0	0	3	85	105	0
特別損失 Extraordinary losses	34	2,099	21	158	-	-	157	0	-	2,103	-	-269
税引前利益 Profit before income taxes and minority interests	29,516	33,301	27,255	34,275	4,339	13,312	6,474	10,148	4,465	8,498	6,844	13,377
法人税等合計 Total income tax and others	8,132	9,607	7,791	8,531	754	3,310	1,870	2,596	1,228	2,090	2,268	2,768
非支配株主に帰属する四半期純利益 Net Profit attributable to minority interests	57	62	84	106	31	6	29	39	7	25	39	18
親会社株主に帰属する当期純利益 Net Profit attributable to Owners of the Parent	21,326	23,630	19,378	25,637	3,554	9,996	4,574	7,512	3,229	6,382	4,536	10,590
1株当たり当期純利益(円) Net Profit per Share (Yen)	522.52	581.33	480.49	633.75	87.89	247.09	113.07	185.67	79.77	157.32	112.74	260.73
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益(円) Net Profit per Share (diluted) (Yen)	517.51	575.62	475.42	628.31	-	-	-	-	-	-	-	-

30 @ TOKYO SEIMITSU

ACCURETECH | 東京精密

Supplementary Data - 貸借対照表 / Balance Sheet

(百万円) (Million Yen)		2023年3月期 FY2023/3	2024年3月期 FY2024/3	2025年3月期 FY2025/3	2026年3月期 FY2026/3
流動資産 Current Assets	現金及び預金 Cash and cash equivalents	40,080	36,782	54,541	53,073
	売上債権※1 Accounts Receivable※1	43,403	42,801	39,809	47,877
	棚卸資産 Inventories	53,482	67,225	69,513	68,022
	その他 Others	7,005	7,022	5,477	5,634
	合計 Total	143,972	153,831	169,341	174,607
固定資産合計 Total Fixed Assets		65,060	71,693	68,610	75,309
総資産 Total Assets		209,032	225,524	237,952	249,917
流動負債 Current Liabilities	買入債務※2 Accounts Payable※2	22,359	17,845	16,665	17,529
	その他 Others	28,588	28,156	30,268	30,350
	合計 Total	50,947	46,002	46,933	47,879
固定負債合計 Total long-term liabilities		12,057	21,094	14,789	9,832
負債合計 Total Liabilities		63,004	67,097	61,723	57,712
純資産合計 Total Net Assets		146,028	158,427	176,229	192,205
負債・純資産合計 Total Liabilities and Net Assets		209,032	225,524	237,952	249,917
有利子負債合計 Total interest-bearing debt		14,191	25,171	20,084	14,713
自己資本比率 Equity Ratio(%)		69.0%	69.4%	73.2%	76.2%
自己資本利益率 ROE(%)		17.3%	12.9%	15.5%	13.6%

※1: 電子記録債権、契約資産を含む
Incl. Electronically recorded monetary claims

※2: 電子記録債務を含む
Incl. Electronically recorded obligations-operating

Supplementary Data - 各種費用, キャッシュフロー/ Expenses and Cash

(百万円) (Million Yen)	2023年3月期 FY2023/3	2024年3月期 FY2024/3	2025年3月期 FY2025/3	2026年3月期 FY2026/3
研究開発費 R&D expenses	8,542	9,042	10,354	12,037
設備投資 Capex	9,725	11,602	10,245	11,069
減価償却費 (のれんの償却を除く) Depreciation (excl. Amortization of goodwill)	3,832	4,673	5,105	5,582

(百万円) (Million Yen)	2023年3月期 FY2023/3	2024年3月期 FY2024/3	2025年3月期 FY2025/3	2025年3月期 FY2026/3
営業活動によるキャッシュフロー Cash flows from operating activities	1,000	4,892	28,824	25,012
投資活動によるキャッシュフロー Cash flows from investing activities	-8,421	-10,563	2,541	-11,491
フリーキャッシュフロー Free cash flows	-7,421	-5,671	31,365	13,520
財務活動によるキャッシュフロー Cash flows from financing activities	-2,174	1,616	-13,991	-15,674
現金及び現金同等物に係る換算差額等 Adjustments	625	755	404	689
現金及び現金同等物の期末残高 Cash and cash equivalents at the end of year	40,036	36,736	54,516	53,052

(人数) (# of People)	2023年3月期 FY2023/3	2024年3月期 FY2024/3	2025年3月期 FY2025/3	2026年3月期 FY2026/3
正社員合計 Total regular employees	2,468	2,658	2,767	2,890
臨時従業員 年間平均雇用人員数 (※1) Average number of part-time employees, not included in the above figure	1,258	1,225	1,258	1,365
従業員合計 (※1) Number of employees	3,726	3,883	4,025	4,255

Supplementary Data - (ご参考) 2026年度 東京精密 マテリアリティ

青字: 2026年度変更

テーマ (合計 6テーマ)	マテリアリティ (合計 23マテリアリティ)
豊かな社会の実現に貢献	社会課題を解決する製品の創出と提供
	未来を創り社会を豊かにする半導体製造への貢献
	精密測定を通じたモノづくりのイノベーションへの貢献
持続可能な社会づくりに貢献する 事業活動の推進	バリューチェーンにおける温室効果ガスの削減
	地球環境に貢献する製品の創出と提供
	環境保全と資源管理の最適化
	サーキュラー・エコノミーの実現
	環境マネジメントシステムの高度化
	バリューチェーンにおけるサステナビリティの推進
ステークホルダーの信用・信頼に応える 企業姿勢の維持・強化	製品品質と安定供給の確保及びカスタマーサポートの充実
	ステークホルダーエンゲージメントの推進
	多様な視点と価値観の尊重
多様な人々が前向きに活々と働ける 職場環境の醸成	心身ともに健康で安全に働ける職場づくり
	従業員エンゲージメントの向上
	コーポレート・ガバナンスの強化
公正な企業活動の基盤となるガバナンスの強化	コンプライアンスの強化
	リスクマネジメントの推進
	人財の確保と育成の推進
事業基盤の強化	研究開発力の強化
	知的財産の管理と活用
	DXの推進
	変革を支える企業風土の醸成
	持続可能な安定経営の実現